



Merkmale

- Enthält kein Silikon
- Höhere Wärmeleitfähigkeit als Silikon
- Kein Separieren
- Keine Verunreinigung von Lotbädern
- Außergewöhnlich niedrige Ausblut- und Verdampfungsrate
- Verträglich mit Metall- und Plastikteilen
- Entspricht MIL-C-47113B
- Großer Temperaturbereich
- Ungiftig
- Schmilzt nicht, trocknet nicht aus, verhärtet nicht
- Entspricht Spezifikation KS 21 343 der Western Electric

Anwendung

Die silikonfreie Wärmeleitpaste wurde entwickelt, um die bekannten Probleme von silikonbasierenden Produkten, wie Verunreinigung und Verdampfung und deren Niederschläge zu eliminieren. Die Mischung basiert auf einem synthetischen thermischen Fett und sichert eine schnelle, wirkungsvolle Wärmeableitung.

Der primäre Vorteil dieses Produkts liegt in der Langzeit-Stabilität. Keine sichtbare Verdampfung oder Ausbluten, selbst nicht unter Vakuum (10⁻⁵ Torr/mil, 24h/100°C). Die Wärmeleitpaste wird unter normalen industriellen Bedingungen nicht austrocknen, verhärten oder schmelzen.

techn. Daten

Konsistenz

320 (Penetration, 60x)
nach ASTM D-217

Spezifisches Gewicht

2,7 g /cm³ bei 25 °C
nach ASTM D-70

Ausbluten

0,1 %/Gewicht bei 200 °C/24h
FTM-321 modifiziert

Verdampfung

0,6 %/Gewicht bei 200 °C/24h
FTM-321 modifiziert

Thermische Leitfähigkeit bei 36 °C

0,70 W/m °K
16,7 x 10⁻⁴ Cal/sec cm °C
4,8 BTU.in (h/FT².°F)
nach der "hot wire" Methode nach
MIL-C-47113B

Elektrische Eigenschaften

305 V/mil Spannungsdurchschlagfestigkeit
bei Spalt 0,05" nach ASTM D-149
4,5 Dielektrizitätskonstante bei 25 °C
1000 Hz nach ADTM D-150
32 ppm/°C thermischer Ausdehnungskoeffizient
1,65 x 10¹⁴ Ohm/cm Volumenwiderstand
nach ASTM D-257

Arbeitstemperatur

-40...200 °C

Aussehen

weiße Paste

Wärmeleitpaste, silikonfrei	MT8800	
Spritze, 3 g Inhalt		A1
Bestellbeispiel:	MT8800	A1